

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2004 年 10 月 21 日 (21.10.2004)

PCT

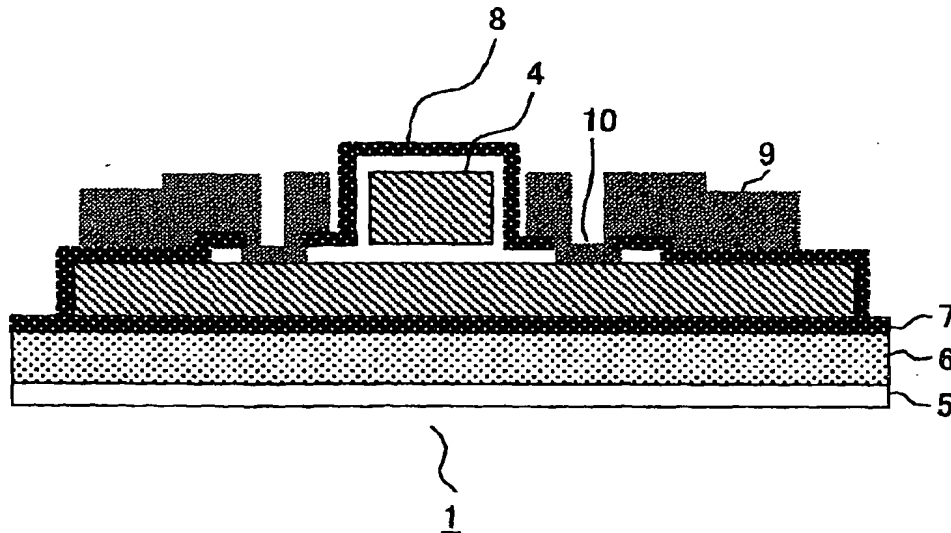
(10) 国際公開番号  
WO 2004/089812 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: B81C 1/00, (72) 発明者; および  
B81B 3/00, H03H 9/24, 3/007 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 多田 正裕 (TADA, Masahiro) [JP/JP]. 木下 隆 (KINOSHITA, Takashi) [JP/JP]. 田中 均洋 (TANAKA, Masahiro) [JP/JP]. 山口 征也 (YAMAGUCHI, Masanari) [JP/JP]. 御手洗 俊 (MITARAI, Shun) [JP/JP]. 難波田 康治 (NANIWADA, Koji) [JP/JP].
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/004822
- (22) 国際出願日: 2004 年 4 月 2 日 (02.04.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2003-098782 2003 年 4 月 2 日 (02.04.2003) JP  
特願2004-068325 2004 年 3 月 11 日 (11.03.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1410001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

[続葉有]

(54) Title: PROCESS FOR FABRICATING MICROMACHINE

(54) 発明の名称: マイクロマシンの製造方法



(57) Abstract: A process for fabricating a micromachine in which removal of a sacrifice layer and sealing can be carried out without requiring any special packaging technology. The process for fabricating a micromachine (1) equipped with an oscillator (4) comprises a step for forming a sacrifice layer around the movable part of the oscillator (4), a step for covering the sacrifice layer with an overcoat film (8) and making a through opening (10) communicating with the sacrifice layer through the overcoat film (8), a sacrifice layer etching step for removing the sacrifice layer through the use of the through opening (10) in order to form a space around the movable part, and a step for sealing the through opening (10) by performing film deposition while reducing the pressure following etching of the sacrifice layer.

[続葉有]